

# TAARIFA

## HESLB yafungua dirisha dogo la 'Samia Skolashipu'

Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu (HESLB) inapenda kuwataarifu wanafunzi wa elimu ya juu nchini kuwa dirisha dogo la kuomba fursa za 'Samia Skolashipu' litakuwa wazi kuanzia April 1 - 10, 2023.

Dirisha hili la pili linafunguliwa ili kuwapa fursa wanafunzi wapya 80 kuomba kupata 'Samia Skolashipu'. Wanafunzi hawa ni wapya wenye ufaulu wa juu katika mihani wa taifa wa kidato cha sita kwa mwaka 2022 katika tahsusi za sayansi.

Wanafunzi hawa, ambao orodha yao inapatikana katika [www.heslb.go.tz](http://www.heslb.go.tz), wanashauriwa kusoma 'Mwongozo wa Skolashipu kwa Mwaka 2022/2023' unaopatikana katika tovuti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ([www.moe.go.tz](http://www.moe.go.tz)). Mwongozo unatoa maelezo ya sifa, vigezo na utaratibu wa kuomba na kupokea malipo kwa wanufaika.

Baada ya kusoma mwongozo, mwombaji wa skolashipu anashauriwa kutembelea [www.heslb.go.tz](http://www.heslb.go.tz) ili kuwasilisha maombi zikiwemo nyaraka muhimu.

Wasiliana na  
Ofisa Mikopo aliyepo  
chuoni au kutuma barua pepe kwa  
[josephat.bwathondi@heslb.go.tz](mailto:josephat.bwathondi@heslb.go.tz)

Imetolewa na:  
Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa  
Elimu ya Juu Dar es Salaam

Alhamisi, Machi 30, 2023